

応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会主催 「第 10 回集積化 MEMS シンポジウム」開催案内

公益社団法人応用物理学会
集積化 MEMS 技術研究会
委員長 平本 俊郎 (東京大学)

●開催主旨と案内

応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会では、各学会との連携を図り、広く人的ネットワークの裾野を広げ、産業界、大学含めた連携の基盤づくりを目指すための活動の一つとして、これまで電気学会センサ・マイクロマシン部門が主催する「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム開催に合わせて「集積化 MEMS シンポジウム」を開催してきました。このセンサ・マイクロマシンシンポジウムはセンサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に開催される日本最大のシンポジウムです。このシンポジウム開催に合わせて「集積化 MEMS シンポジウム」を開催することで、応用物理の新たな展開が期待されます。今年も第 10 回集積化シンポジウムを開催する運びとなりました。今回は Future Technologies from SAPPORO として札幌市民交流プラザにて開催します。みなさまの参加と論文投稿をお願い申し上げます。

●会期 2018 (H30) 年 10 月 30 日 (火) - 11 月 1 日 (木)

●会場

札幌市民交流プラザ
〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 1 丁目
TEL: 011-242-5800
<http://www.sapporo-community-plaza.jp/access.html>
第 35 回センサシンポジウム HP
<http://www.sensorsymposium.org/>



集積化 MEMS 技術研究会 HP
<http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>

●論文募集分野

応用物理学会関連として、CMOS-MEMS 技術、センサ用薄膜、異種材料の成膜技術、三次元形状形成、バイオ・生体用関連デバイス・材料、ウェアプロセステクニク、シミュレーション、センサ用回路設計技術、IoT 関連応用、RF-MEMS 技術、エネルギーハーベスト技術、実装技術、ナノツール、機能性メンブレンなどについて広く論文を募集します。

●発表形式

講演形式 (15 分質疑応答 3 分を含む) およびポスター形式

●使用言語

日本語または英語

●発表申込方法

発表概要 (A4 版 2 ページ、PDF フォーマット) を、上記第 35 回センサシンポジウムホームページ <https://www.semiconportal.com/ft2018/entry.php?d=4> から投稿してください。投稿された論文は論文委員会で審査され、採否を通知します。



発表申込締切 2018 (平成 30) 年 6 月 25 日 (月)
採否結果通知 2018 (平成 30) 年 7 月 23 日 (月)
掲載論文締切 2018 (平成 30) 年 8 月 27 日 (月)
※採択後の講演論文 (PDF、A4、2~6 ページ) 投稿についてはホームページをご覧ください。

●表彰

発表の中から研究会の規約のもとに若手研究者、優秀論文を表彰します。

●参加費

本シンポジウムに参加登録すると同時開催される「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムにも参加することができます。申し込みは、第 35 回センサシンポ HP からお願いします。

参加費一覧

	早期割引 (10/13 まで)	通常 (10/14 以降、当日)
	参加費	参加費
会員	22,000 円	30,000 円
非会員	45,000 円	55,000 円
学生会員	5,000 円	8,000 円
学生非会員	13,000 円	18,000 円

・会員は主催・協力・協賛学協会会員

●問合せ先

★集積化 MEMS シンポジウム実行委員長
積 知範 (オムロン)

E-mail: tomonori_seki@omron.co.jp
応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会事務
E-mail: integmems@lsi.pi.titech.ac.jp

★第 35 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局

株式会社セミコンダクタポータル
〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5

メソニック MT39 ビル 4F

電話: 03-5733-4971、FAX: 03-5733-4973

E-mail: sensorsympo_2018@semiconportal.com